

Doc.No : NR020909-2

2002年9月9日

300ミリウエハの裏面、端面の洗浄に特化した枚葉式洗浄装置を発売

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区)の半導体機器カンパニー(社長：末武隆成)は、配線工程に対応した300ミリウエハ用枚葉洗浄装置「MP-3000CB」を10月1日から販売します。

この「MP-3000CB」は、300ミリウエハ対応の洗浄装置「MP-3000」(2001年4月発売)をベースに、銅配線処理後のウエハ裏面およびベベル部(端面)の洗浄・エッチングに特化した装置です。

半導体業界では、生産性の向上を目指し、台湾やアメリカを中心に300ミリウエハの導入が進むのと同時に、半導体デバイスの高集積化に伴い、配線は従来のアルミから電気抵抗の低い銅への移行が主流となりつつあります。しかし、銅はアルミに比べて、酸化膜の内部に入り込んで配線をショートさせてしまう可能性が高まります。そこで、銅配線を使用したウエハは裏面やベベル部などを、アルミ配線より徹底して洗浄する必要があります。

本装置は、このような次世代デバイス生産における高度な洗浄の要求に応えたもので、MP-3000の処理部のウエハ保持方式を改良することで裏面およびベベル部の洗浄に対応。ウエハ裏面からエッチング液、純水リンスを連続吐出させ、表面への影響を最小限に押さえ、裏面、ベベルのみを洗浄します。また、処理の際の回転数を変えることで、表面外周部における薬液がかかる範囲をコントロール。純水リンス時にはエッチング時よりも広い範囲を洗浄することで、薬液の残留を防ぎます。

<販売開始予定日>

2002年10月1日

<国内希望販売価格(消費税別)>

2億円(仕様により異なる)

<年間販売予定台数>

30台

**MP-3000CB**

☆この画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、下記URLよりダウンロードできます。
(<http://www.screen.co.jp/press/photo.html>)